

证券代码：301348

证券简称：蓝箭电子

佛山市蓝箭电子股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	广东粤财基金管理有限公司、广州南粤澳德股权投资基金管理有限公司、广东大兴华旗资产管理有限公司、广东睿和投资管理有限公司、广东易高智汇股权投资基金管理有限公司、广东凯鼎投资有限公司、企悦（广东）资本投资有限公司、广州光正投资管理有限公司、毅达资本、广东鼎诺资本管理有限公司、佛山禅城控股投资有限公司、广东国健安证券投资基金管理有限公司、蓝山基金、红塔基金、佛山建发绿色建材有限公司、佛山建发私募基金管理有限公司、招商银行佛山分行、广发基金、广东五元集团有限公司、国信证券、佛山市上市公司协会等机构
时间	2024年10月14日
地点	佛山市禅城区古新路45号佛山市蓝箭电子股份有限公司5楼会议室
上市公司接待人员姓名	1、董事、总经理袁凤江 2、董事、财务总监赵秀珍 3、董事、副总经理、董事会秘书张国光 4、证券事务代表林品旺
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司代表带领投资者参观了公司生产线，并就公司发展历程、产品结构、生产工艺等信息为投资者进行了详尽的介绍。在随后的座谈环节中，投资者与公司进行了充分的沟通交流，投资者提出的问题及公司回复情况如下：</p> <p>1：公司主营业务产品的结构拆分情况。</p> <p>答：公司从事半导体封装测试业务，为半导体行业及下游领域提供分立器件和集成电路产品。从产品下游应用领域看：公司产品主要应用于消费类电子为主；其次包括电源领域、工业控制、智能家居、安防、网络通信、汽车电子等多个领域。</p>

2、公司在 2024 年及未来的发展方向。

答：随着大电流、高电压等应用场景需求增长，功率器件产品需求持续旺盛，应用了 Clip bond 等技术的产品封装系列能够更好的满足市场对大电流、高电压等功率器件的要求，在工业控制、新能源汽车等领域广泛得到应用。公司将基于现有的功率器件封装的核心技术，持续紧密围绕大电流、耐高温、高功率器件封装技术开展研发，并在封装过程的粘片、压焊等多个环节不断创新。同时，在芯片级贴片封装技术（DFN/QFN 封装等）方向，公司将顺应行业发展趋势，逐步向更小尺寸封装和更大尺寸封装、高功率密度方向发展。

3、公司研发投入情况。

答：公司的研发投入的变化主要受公司研发计划和研发项目所处阶段的影响，公司的研发计划根据市场需求和客户需求而制定。公司将持续积极加大研发投入，紧跟行业研发热点，将技术创新作为自身发展的重要驱动力。公司每年研发费用支出均达千万元以上，占营业收入比重超过 4%；公司目前研发人员约 150 人，占比超过 10%，核心技术人员稳定。

同时，公司注重人才的引进和培养，逐步建立了较为完善的人才引进与培养机制，采取多元化的薪酬激励体系，促进内部竞争，培养专业化人才队伍。加强与各大高校合作招聘，推行产学研结合机制并寻求外部研发合作等方式吸收专业技术人才，通过各种方式补充相应的人才以适应公司不断发展的需要。

4、公司上半年毛利率下降原因。

答：2024 年上半年，公司销量同比有所增长，但产品价格有较大幅度的下滑，主要系全球半导体市场仍处于周期底部爬坡阶段，尽管以智能手机、电脑为代表的消费电子有复苏迹象，但复苏力度较为孱弱，需求整体受限；叠加下游客户仍处于去库存阶段，市场竞争加剧，产品价格承压，综合影响下导致利润和销售收入同比下降。

受公司产量增加影响，并叠加材料价格上涨的因素，公司营业成本有所增加，导致公司利润下降。

2024 年上半年，公司在营业收入下行的同时营业成本有所增加，主要受金属原材料涨价影响和产量增加导致材料成本和人工成本上升较多，使得毛利率下滑。

5、公司业绩提升的应对措施。

答：蓝箭电子将结合国家、市场对公司的期望和要求，在做强做大核心元器件主业的基础上，通过资本运作延伸产业链条，做大发展规模。

营销策略：在市场方面，继续深耕主营业务发展，加快开拓新兴产业、工业类、车规级产品等领域，采取多产品系列延伸策略，为客户提供整合配套及解决方案。

生产制造策略：通过募投项目建设打造佛山市半导体器件产业基地。采取贴近客户，自动化、信息化、提升质量、持续创新、绿色制造等策略助力公司生产制造的发展。

研发策略：完成半导体封装研究实验室、封装可靠性与失效性分析实验室软硬件的建设，聚焦于对宽禁带功率半导体器件封装研究、Clip bond 封装工艺等课题，采取技术跟随策略，开展国际化基础和前瞻技术合作与

	<p>风险投资。</p> <p>6、蓝箭未来成本管控的情况。</p> <p>答：公司在数字化、智能制造领域目前已开展全部产线设备数字化管理和自动搬运管理推动升级。公司已经引入应用机器人封装技术、AI 智能管理、制造业大数据分析系统等，目前已通过自主创新在封测全流程实现智能化、自动化生产体系的构建，实现了供、产、销、研有机互联，能够从订单接收到产品出库实现全流程质量控制和实时监测，实现全流程的智能互联。未来，随着国内半导体生产技术持续提升，公司将继续推进和实现半导体生产设备、生产材料的国产化替代进程。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 10 月 14 日